

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成30年12月13日(2018.12.13)

【公開番号】特開2018-44242(P2018-44242A)

【公開日】平成30年3月22日(2018.3.22)

【年通号数】公開・登録公報2018-011

【出願番号】特願2017-172733(P2017-172733)

【国際特許分類】

C 23 C 18/20 (2006.01)

C 23 C 18/16 (2006.01)

H 05 K 3/18 (2006.01)

【F I】

C 23 C 18/20 Z

C 23 C 18/16 A

H 05 K 3/18 K

H 05 K 3/18 E

【誤訳訂正書】

【提出日】平成30年11月2日(2018.11.2)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0011

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0011】

用語の成型相互接続装置、つまりMIDは、典型的には3Dの形状または形態を有する集積電子回路トレースを含む熱可塑性プラスチック射出成型品を意味する。用語「バックグラウンドめっき」は、金属の堆積が意図されていない、ポリマーまたはプラスチックの表面への無作為な金属堆積を意味する。用語「オーバーめっき」は、所望の回路パターンを超えた金属めっき、及び制御不能な金属めっきを意味する。用語「モノマー」または「モノマーの」は、同一または同類分子のうちの1つ以上と結合する場合がある単一分子を意味する。用語「オリゴマー」は、単一分子を形成するように結合した2つまたは3つのモノマーを意味する。用語「ポリマー」は、結合した2つ以上のモノマー、または単一分子を形成するように結合した2つ以上のオリゴマーを意味する。用語「ポリマー」は、コポリマーを含む。用語「隣接する」は、2つの異なる表面を互いに接触させて共通の境界面を形成する場合の接合を意味する。用語「プリント回路基板」及び「プリント配線板」は、本明細書の全体にわたって互換的に使用される。用語「めっき」及び「堆積」は、本明細書の全体にわたって互換的に使用される。すべての量は、特記されない限り、重量パーセントで示される。すべての数値の範囲は、包括的であり、そのような数値の範囲が合計100%になるという制約を受けることが論理的である場合を除き、順不同で組み合わせ可能である。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0036

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0036】

本発明が無電解めっきされる場合があるすべての金属を無電解堆積するために使用され得ることを想定する一方、好ましくは、金属は、銅、銅合金、ニッケル、またはニッケル

合金から選択される。市販の無電解銅めっき槽の例は、CIRCUS POSIT(商標)880無電解銅槽(マサチューセッツ州マルボロ、Dow Advanced Materialsより入手可能)である。市販の無電解ニッケルめっき槽の別の例は、DURAPOSIT(商標)SMT 88(マサチューセッツ州マルボロ、Dow Advanced Materialsより入手可能)である。市販の無電解ニッケル槽の例は、DURAPOSIT(商標)SMT 88無電解ニッケル(マサチューセッツ州マルボロ、Dow Advanced Materialsより入手可能)である。

【誤訳訂正3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0046

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0046】

各々のポリマー基板が無電解銅めっきされた後、基板は室温下のDI水ですすぐれ、銅堆積の品質について分析された。すべての銅堆積は、均一かつ明るく見えた。バックグラウンドめっきまたはオーバーメっきは、どの基板でも観察されなかった。

【誤訳訂正4】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0049

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0049】

ポリマー基板は、銅堆積の品質について分析され、またバックグラウンドめっきがないかについても分析された。すべての銅堆積は、明るく滑らかに見えた。下の表4は、バックグラウンドめっきと、プライマー組成物の塩化銅の濃度とに関する結果について開示する。

【誤訳訂正5】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0054

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0054】

ポリマー基板は、銅堆積の品質について分析され、またバックグラウンドめっきがないかについても分析された。すべての銅堆積は、明るく滑らかに見えた。下の表6は、バックグラウンドめっきと、プライマー組成物の塩化銅の濃度とに関する結果について開示する。